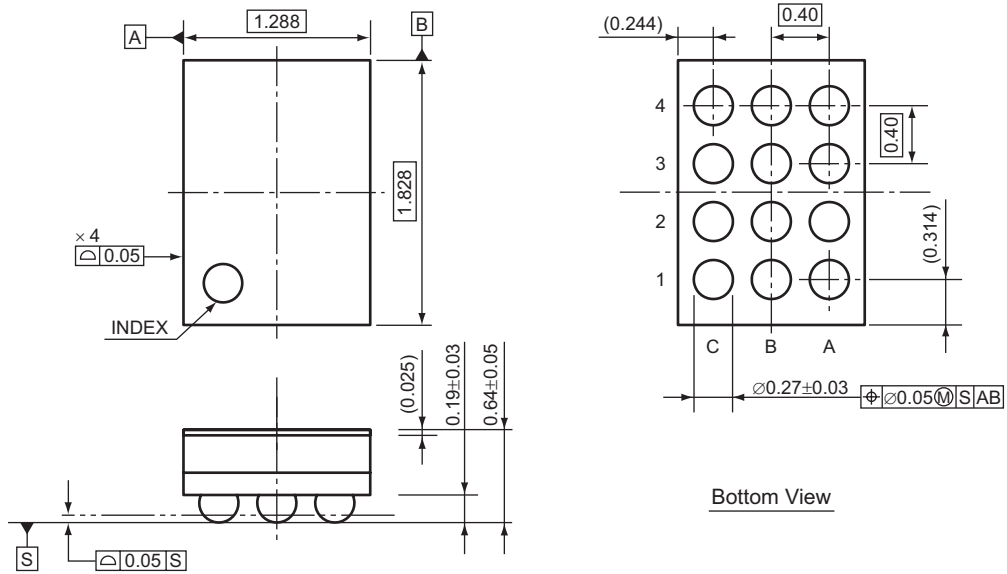


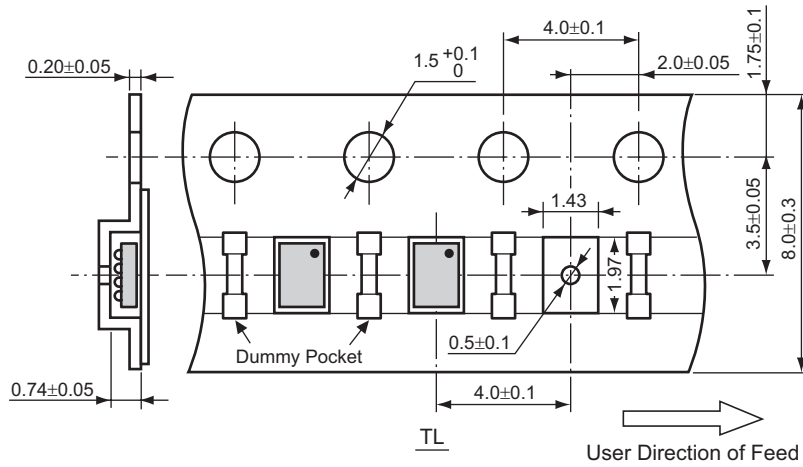
WLCSP-12-P2

単位: mm

■ パッケージ外形図

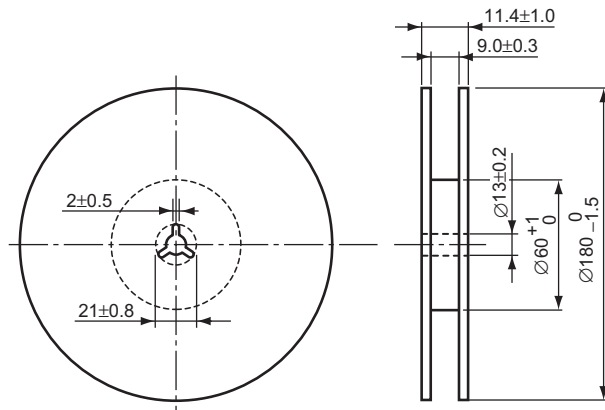


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リユースリール (EIAJ-RRM-08Bc)

1 リール = 5000 個



## ■ 許容損失について (WLCSP-12-P2)

WLCSP-12-P2パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

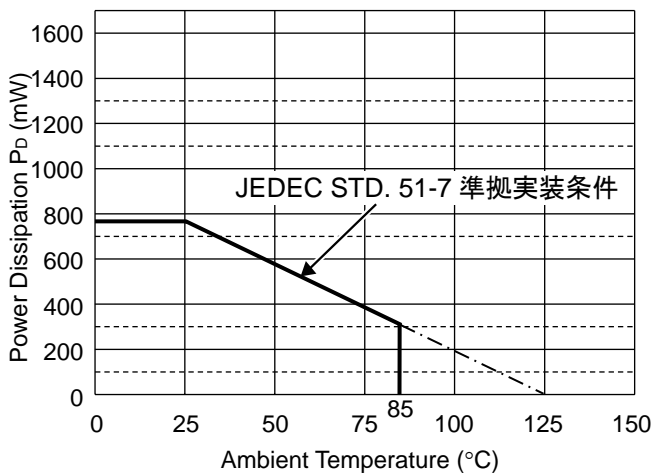
### 測定条件

JEDEC STD. 51-7 準拠実装条件	
測定状態	基板実装状態 (風速 0 m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (4層基板)
基板サイズ	76.2 mm × 114.3 mm × 1.6 mm
配線率	表裏層: 60 mm 角, 配線率 10%以下 内層: 74.2 mm 角, 配線率 100%

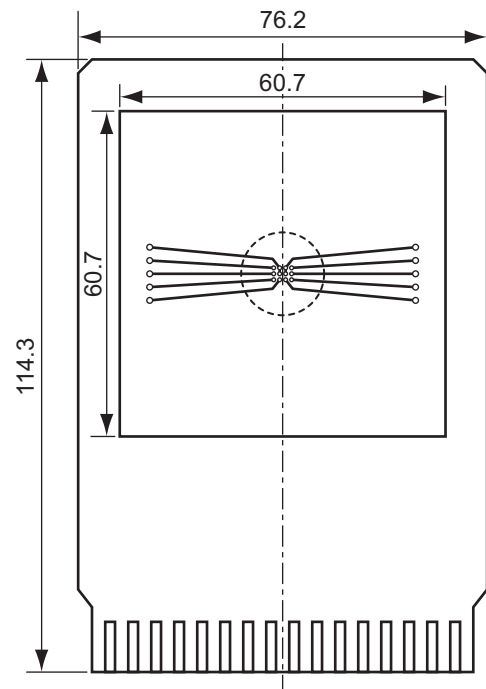
### 測定結果

(Ta = 25°C, Tjmax = 125°C)

JEDEC STD. 51-7 準拠実装条件	
許容損失	760 mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125-25^\circ\text{C})/0.76\text{W} = 131^\circ\text{C/W}$
	$\theta_{jc} = 15^\circ\text{C/W}$



許容損失特性

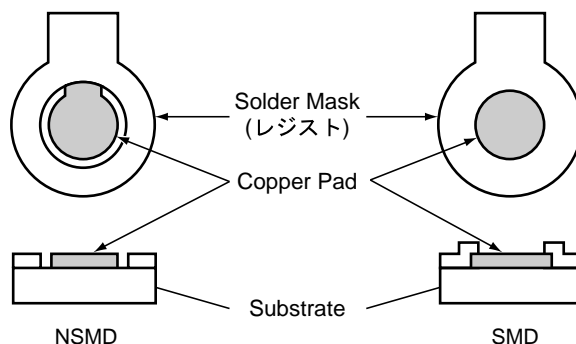


基板レイアウト

○ IC 実装位置

単位: mm

■ 基板パッド推奨寸法 (WLCSP)



NSMD and SMD Pad Definition

Pad definition	Copper Pad	Solder Mask Opening
NSMD (Non-Solder Mask defined)	0.25 mm	Min. 0.30 mm
SMD (Solder Mask defined)	Min. 0.30 mm	0.25 mm

パッド寸法の最適値は基板材料、半田ペースト材料、半田付け方法、装置精度などによって変わりますので、実際の設計に当たっては状況に合わせて適正化を計って下さい。

ステンシル開口部（推奨）… φ0.25 mm

Pbフリー製品については、共晶半田ペーストには実装しないようにして下さい。